



Orbotech Diamond™ 10W

最佳防焊直接成像



Orbotech Diamond 10W

Orbotech Diamond 10W 是高產能高階的防焊直接成像 (DI) 解決方案，專為應對白色防焊 PCB 應用的獨特挑戰而設計 (例如 miniLED 背光模組)。經業界驗證的 Orbotech Diamond 10W 是用於白色防焊系統的專用機型，即使是最複雜的設計也可實現高品質成像及高產能。

採用 KLA 專利的 SolderFast™ 技術，Orbotech Diamond 10W 提升了白色防焊直接成像的能力，在加強了成像精確性及品質的同時減少了整體擁有成本 (TCO)。



優勢

高品質成像

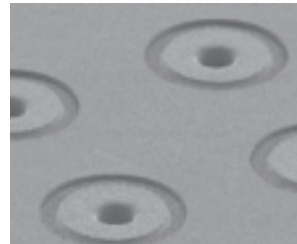
- 白色防焊的高品質成像
- 多波長可實現高品質側壁及優異的表面品質
- 顯著減少白色防焊的底切
- 高景深 (DOF) 適用於高低差大的表面

高產能，快速產出

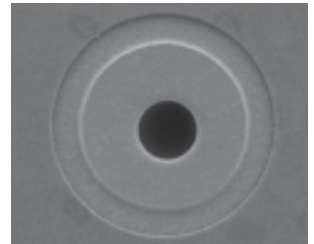
- 專利高能量照明光源
- 一次掃描成像，單次曝光即可完成全板均勻成像
- 雙檯面傳輸機製優化成像時間
- 即時靶點識別及捕捉功能

卓越的成像精度

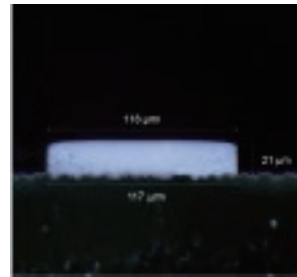
- 對位精度高達 $\pm 10\mu\text{m}$
- 高階漲縮模式和演算法，克服板材變異



高品質防焊成像



高對位精度



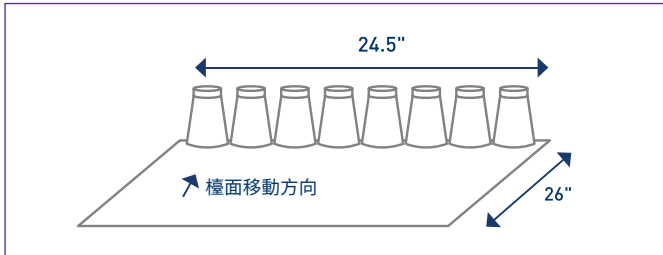
Orbotech Diamond 10W
白色防焊橋，最小底切



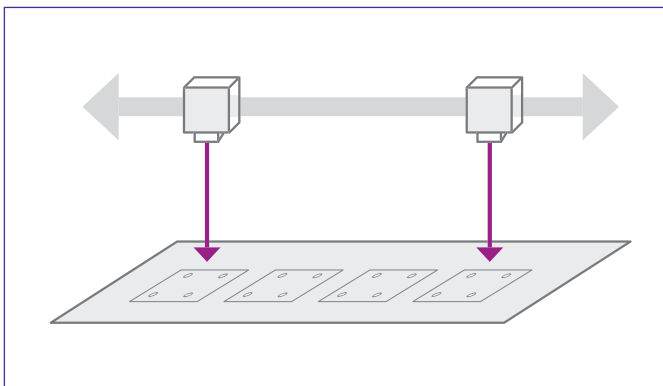
其他防焊直接成像解決方案
白色防焊橋，明顯的底切



高品質成像和快速產出

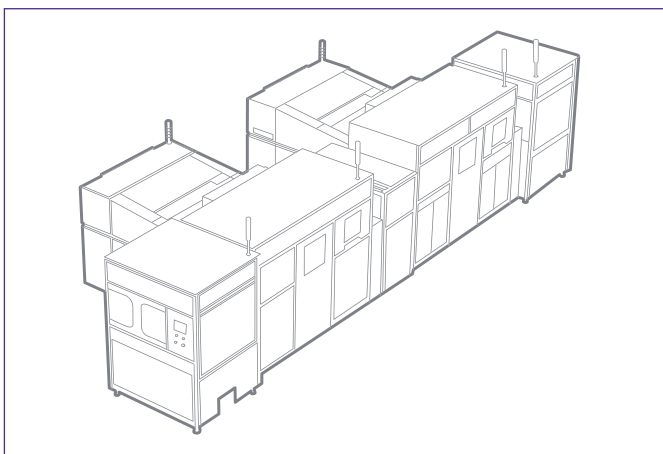


一次成像實現快速產出，成像均勻且沒有拼接問題

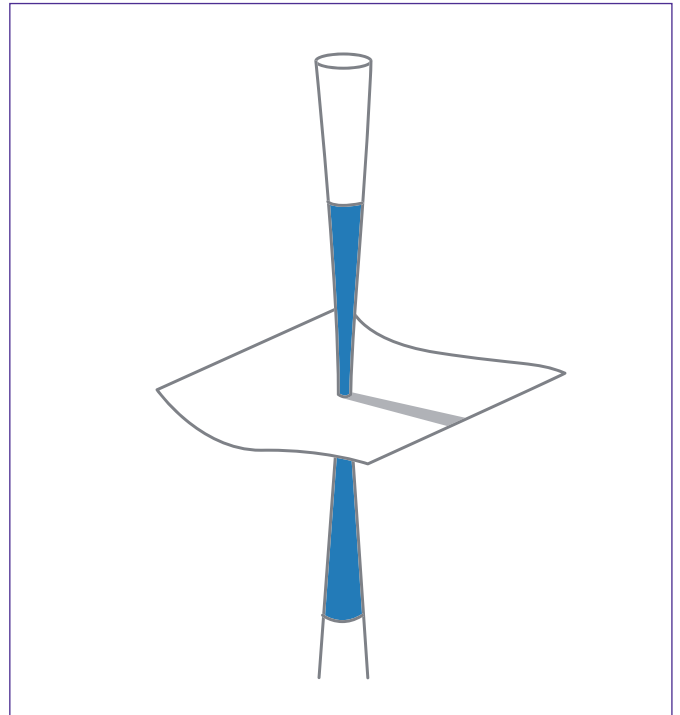


即時靶點識別及捕捉

高產能量產解決方案



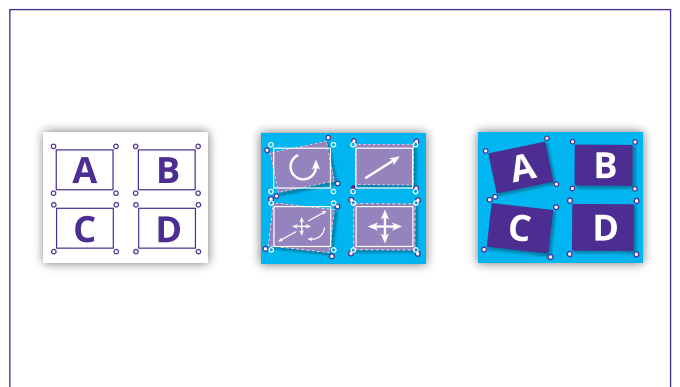
支援自動化



高景深 (DOF) 適用於高低差大的表面

卓越的成像精度

高階漲縮模式和演算法可以克服具有挑戰性的板子變形，包括自動漲縮，局部漲縮及非線性漲縮



CAM 數據

板子

圖像

規格

最小開窗*	100µm
最小防焊橋*	75µm
對位精度**	±10µm
最大板子尺寸 (X/Y)	25" x 26" (635mm x 660mm)
最大曝光尺寸 (X/Y)	24.5" x 26" (622mm x 660mm)
曝光能量範圍	50-2,200mJ/cm ²
尺寸	高: 1,960mm 深: 3,226mm 寬: 1,900mm
重量	5,000Kg
應用	白色防焊曝光

* 取決於防焊油墨類型及製程

** 所有值均為 3σ

- 上述規格如有變更,恕不另行通知。

KLA 支持

保持系統生產力是 KLA 良率優化解決方案不可或缺的一部分。包括系統維護、全球供應鏈管理、降低成本和減少報廢、系統遷移、加強性能和生產率以及轉售認證工具。

©2022 KLA Corporation 全球範圍內保留所有權利。KLA 保留無需通知而變更硬體和/或軟體規格的權利。Orbotech 是 KLA 公司 Orbotech Limited 的註冊商標。KLA 和 KLA 標識是 KLA Corporation 的註冊商標。所有品牌或產品名稱可能是各自公司的商標。

KLA Corporation
www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 4.1_4-11-2022